



中华人民共和国国家标准

GB/T 35010.8—2018/IEC/TR 62258-8:2008

半导体芯片产品 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式

Semiconductor die products—
Part 8: EXPRESS model schema for data exchange

(IEC/TR 62258-8:2008, IDT)

2018-03-15 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	1
5 数据交换	2
附录 A (规范性附录) EXPRESS 格式	3
附录 B (资料性附录) STEP 物理文件格式示例	21

前 言

GB/T 35010《半导体芯片产品》分为以下部分：

- 第 1 部分：采购和使用要求；
- 第 2 部分：数据交换格式；
- 第 3 部分：操作、包装和贮存指南；
- 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求；
- 第 5 部分：电学仿真要求；
- 第 6 部分：热仿真要求；
- 第 7 部分：数据交换的 XML 格式；
- 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式。

本部分为 GB/T 35010 的第 8 部分。

本部分使用翻译法等同采用 IEC/TR 62258-8:2008《半导体芯片产品 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 2900（所有部分） 电工术语[IEC 60050(所有部分)]；
- GB/T 35010.1—2018 半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用要求（IEC 62258-1:2009, IDT）；
- GB/T 35010.2—2018 半导体芯片产品 第 2 部分：数据交换格式（IEC 62258-2:2011, IDT）；
- GB/T 35010.4—2018 半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求（IEC/TR 62258-4:2012, IDT）；
- GB/T 35010.5—2018 半导体芯片产品 第 5 部分：电学仿真要求（IEC 62258-5:2006, IDT）；
- GB/T 35010.6—2018 半导体芯片产品 第 6 部分：热仿真要求（IEC 62258-6:2006, IDT）。

本部分做了下列编辑性修改：

- 删除了 IEC/TR 62258-8 中 5“Data exchange”中最后一段对下载材料的说明。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本部分起草单位：清华大学、中国电子科技集团公司第五十八研究所、浪潮(北京)电子信息产业有限公司、灿芯半导体(上海)有限公司、中国航空工业集团公司第六三一研究所。

本部分主要起草人：王自强、贺娅君、秦济龙、庄志青、郭蒙。

半导体芯片产品

第 8 部分:数据交换的 EXPRESS 格式

1 范围

GB/T 35010 的本部分用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用。其中半导体芯片产品包括:

- 晶圆;
- 单个裸芯片;
- 带有互连结构的芯片和晶圆;
- 最小或部分封装的芯片和晶圆。

本部分规定了数据交换所需元素的 EXPRESS 格式;满足 IEC 62258-1、IEC 62258-5 及 IEC 62258-6 的实施要求;补充 IEC 62258-2 中定义的数据交换结构;兼容且补充 IEC 62258-4 中的信息表。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16656.11—2010 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第 11 部分:描述方法: EXPRESS 语言参考手册 (ISO 10303-11:2004, IDT)

GB/T 16656.21—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第 21 部分:实现方法: 交换文件结构的纯正文编码 (ISO 10303-21:2002, IDT)

IEC 60050 (所有部分) 国际电工词汇(International Electrotechnical Vocabulary)

IEC 62258-1 半导体芯片产品 第 1 部分:采购和使用要求(Semiconductor die products—Part 1: Requirements for procurement and use)

IEC 62258-2 半导体芯片产品 第 2 部分:数据交换格式(Semiconductor die products—Part 2: Exchange data formats)

IEC 62258-4 半导体芯片产品 第 4 部分:芯片使用者和供应商要求(Semiconductor die products—Part 4: Questionnaire for die users and suppliers)

IEC 62258-5 半导体芯片产品 第 5 部分:电学仿真要求(Semiconductor die products—Part 5: Requirements for information concerning electrical simulation)

IEC 62258-6 半导体芯片产品 第 6 部分:热仿真要求(Semiconductor die products—Part 6: Requirements for information concerning thermal simulation)

3 术语和定义

IEC 60050(所有部分)和 IEC 62258-1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

本部分中的 EXPRESS 格式遵循 GB/T 16656.11—2010,允许采用 GB/T 16656.21—2008 中定义